公司代码:688403 公司简称:汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

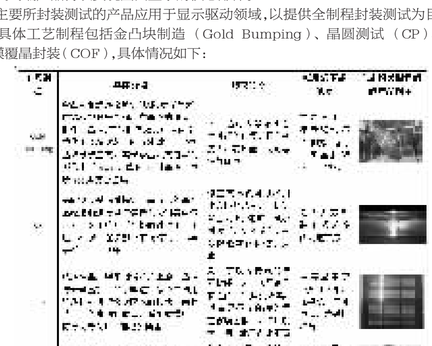
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郑瑞俊(代行)	王赞
办公地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域,具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造为核心,并综合晶圆测试及后段玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装环节,形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

公司目前主要所封装测试的产品应用于显示驱动领域,以提供全制程封装测试为目标,涉及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造(Gold Bumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF),具体情况如下:



(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,在OSAT模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司根据客户需求,通过工艺设计,利用封装测试设备,自行购买封装测试原辅料,对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务收取加工服务费的方式以获取收入和利润。

2、采购模式

公司的采购模式为按需采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单并签约。

对于主要采购材料,公司一般会与供应商约定年度协议价格,未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款,由物料采购部根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后,到期支付款项。

采购材料到货后由品质保障部进行验收,品质保障部核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检,检验合格后在系统中制作验收单,经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制,以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购,评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等,并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面,对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的"客户定制,以销定产"受托加工生产模式,即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料,公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料,接着根据客户需求完成相应工艺制程,而后将成品交付予客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务,拥有专业的工程技术和生产管理团队,并配备了专业的高精度自动化生产设备,可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度。作为集成电路封装测试企业,公司需要对客户的技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务,并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式,公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点,整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下,与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒,并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势,进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为集成电路高端先进封装测试服务,根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的集成电路制造业(C3973),具体细分行业为集成电路封装测试业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于"1 新一代信息技术产业"之"1.2 电子核心产业"之"1.2.4 集成电路制造业"。

(2)行业发展阶段及基本特点

半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类,广泛应用于消费类、高性能计算、通信类、汽车和工业等重要领域。其中,集成电路是20世纪50年代发展起来的一种半导体微型器件,是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺,按照一定的电路互联,把晶体管、电阻、电容、电感等半导元器件及连接导线,全部集成在微型硅片上,构成具有一定功能的电路,然后封装成电子微型器件,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。集成电路是半导体产业的核心,因为其技术的复杂性,产业结构具备高度专业化的特征,可细分为芯片设计、晶圆制造、封装测试三个子行业,封装测试行业位于产业链的中下游,该业务实质上包括了封装和测试两个环节,但由于测试环节一般也主要由封装厂商完成,因而一般统称为封装测试业。

封装是将芯片在基板上布局、固定及连接,并用绝缘介质封装形成电子产品的过程,目的是保护芯片免受损伤,保证芯片的散热性能,以及实现电信号的传输。测试则包括进入封装前的晶圆测试以及封装完成后的成品测试,晶圆测试主要检验的是每个晶粒的电性,成品测试主要检验的是产品电性和功能。

封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业,在世界上拥有较强竞争力,全球的封装测试产业正在向中国大陆转移。国内的集成电路产业结构中芯片设计、晶圆制造、封装测试各环节总体销售规模呈现均衡的态势,有利于形成集成电路行业的内循环,随着上游芯片设计产业的加快发展,也能够推进处于产业链下游的封装测试行业的发展。

封装技术历经较长的发展过程,形成了复杂多样的封装形式,大致可以划分为五个发展阶段:20世纪70年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段,以通孔插装型封装为主;20世纪80年代以后开始进入第二阶段,以表面贴装型封装为主;20世纪90年代以后,以芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、球栅阵列封装(BGA)为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟,进入封装技术发展的第三阶段;20世纪末开始,凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)等技术推动集成电路封装进入第四阶段;进入21世纪之后,倒装封装(FC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、系统级单芯片封装(SoC)、扇出型封装(Fan-out)等形式的集成电路封装层出不穷,封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》,并结合行业内按照封装工艺分类的惯例,封装分为传统封装(第一阶段和第二阶段)及先进封装(第三至第五阶段)。

传统封装与先进封装的主要区别包括键合方式由传统的引线键合发展为球状凸点焊接,封装元件概念演变为封装系统,封装对象由单芯片向多芯片发展,由平面封装向立体封装发展。目前,全球封装行业的主流技术处于以CSP、BGA为主的第三阶段,并向以倒装封装(FC)、凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)、系统级单芯片封装(SoC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

集成电路产业诞生于美国,并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来,但是随着产业的技术进步和市场发展,封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区,也是目前全球最大的集成电路封装测试基地,中国大陆位居其次。2010年以来,全球集成电路产业与显示面板产业向中国大陆转移的趋势增强。2018年中美贸易战后,基于供应链安全的战略考量,在显示驱动芯片领域甚至更广泛的集成电路领域,越来越多的晶圆厂和设计公司顺应向中国大陆产业转移的大趋势,中国大陆的晶圆代工产能快速攀升,并且众多Fabless设计公司也将封装测试订单逐步转移至中国大陆。

(3)主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业,先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征,决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。显示驱动芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求,客户验证和导入的周期较长,目前国内仅有少量企业具备显示驱动芯片封装测试全流程核心工艺技术并批量稳定供应头部客户。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

金凸块制造环节具有溅镀、黄光(光刻)、蚀刻、电镀等多道环节,需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚,对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求,并且显示驱动芯片成本经济性也对金凸块制程当中的黄金用量控制技术提出了很高的要求,因而目前中国大陆具备凸块制造能力的封测企业较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板,单块液晶面板的价值较高,特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户,封测企业将面临较大金额的质量赔付,并且还存在声誉损失甚至客户流失。正是因为客户以及终端对良率的高要求,倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率,保证生产稳定性,行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力,及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一,具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。

根据Frost & Sullivan按2020年出货量口径统计,公司在显示驱动芯片封测领域全球市场占有率约为5.01%,在中国大陆市场占有率约为15.71%。随着合肥生产基地12吋显示驱动芯片封测扩能项目逐步实施,同时子公司江苏汇成开始投资建设12吋晶圆封测项目,公司12吋显示驱动芯片封测产能持续扩充,出货量稳步增长,市场占有率逐步提高。

凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与出众的服务能力,公司积累了优质的客户资源,包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等知名芯片设计企业,公司产品服务质量已得到行业客户的高度认可,并曾获得全球领先的显示驱动IC设计公司联咏科技颁发的最佳品质供应商等荣誉。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着智能手机、智能穿戴等电子产品持续向小型化、多功能化方向发展,对芯片在集成化、小尺寸、低功耗等方面的要求也越来越高。在后摩尔定律时代,以FC、2.5D/3D封装、Fan-out、SiP、Chiplet封装等为代表的先进封测正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向,先进封装在整体封装环节的占比正稳步提升。根据Yole的数据,2020年先进封装全球市场规模304亿美元,在全球封装市场的占比为45%;预计2026年先进封装全球市场规模约475亿美元,占比达50%。2020-2026年全球先进封装市场的CAGR约7.7%,相比同期整体封装市场(CAGR约为5.9%)和传统封装市场,先进封装市场的增长更为显著,将成为封测市场的主要增长点。

特别是近年来人工智能、云计算等下游新兴应用场景的需求飞速发展,正在加速集成电路产业供应链的变革与发展,对封测工艺及产品性能提出了更高的要求,将进一步推动先进封测技术进行迭代并快速增长,先进封测领域有望迎来一轮快速发展机遇。

公司掌握的凸块制造技术、倒装封装工艺是Chiplet等先进封装技术的基础。公司正就Chiplet等先进封装技术的具体应用及解决方案持续与客户进行对接及探讨,并将基于客户的实际需求适时开展具体应用。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,195,632,455.80	2,037,920,157.41	56.81	1,749,906,348.75
归属于上市公司股东的净资产	2,903,705,902.53	1,393,601,109.34	108.36	1,142,470,909.36
营业收入	939,652,817.36	795,699,929.99	18.09	618,926,702.71
归属于上市公司股东的净利润	177,224,972.73	140,318,165.49	26.30	-4,005,024.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,181,697.44	93,931,888.59	34.33	-41,908,225.47
经营活动产生的现金流量净额	601,141,680.25	295,398,927.37	103.50	151,090,002.46
加权平均净资产收益率(%)	9.19	10.71	减少1.52个百分点	-0.96
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	6.93	7.62	减少0.69个百分点	7.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	230,355,848.53	231,639,705.49	236,130,880.99	241,526,382.35
归属于上市公司股东的净利润	48,647,931.85	43,858,057.60	49,810,012.83	34,908,970.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,703,362.96	37,135,626.96	32,544,785.78	21,797,921.74
经营活动产生的现金流量净额	190,089,114.78	125,571,181.49	176,619,631.31	108,861,752.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,440
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	0	174,103,622	20.85	174,103,622	174,103,622	无	0	其他
合肥新汇成微电子股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	147,903,000	17.72	147,903,000	147,903,000	无	0	其他
嘉兴高和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	7.19	60,000,000	60,000,000	无	0	其他
安徽志道投资有限公司	0	40,000,000	4.79	40,000,000	40,000,000	质押	6,858,720	境内非国有法人
杨会	0	23,593,934	2.83	23,593,934	23,593,934	无	0	境内自然人
四川鼎祥股权投资基金有限公司	0	18,181,818	2.18	18,181,818	18,181,818	无	0	境内非国有法人
蔚华电子科技(上海)有限公司	0	17,000,000	2.04	17,000,000	17,000,000	无	0	境内非国有法人
扬州耕天下商业运营管理合伙企业(有限合伙)	0	15,000,000	1.80	15,000,000	15,000,000	无	0	其他
扬州和安商业运营管理合伙企业(有限合伙)	0	14,850,000	1.78	14,850,000	14,850,000	无	0	其他
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)	0	14,545,455	1.74	14,545,455	14,545,455	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑瑞俊、杨会为公司实际控制人,两人系夫妻关系。扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)为杨会女士所控制的企业,系公司控股股东。汇成投资控股有限公司和宝信国际投资有限公司为郑瑞俊先生所控制的企业。汇成投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司与Advance Allied Limited、Great Title Limited、Worth Plus Holdings Limited、Huadefu Co Limited、Win Plus Corporation Limited、Strong Lion Limited在报告期内暂未完成开立证券账户,其股份暂存合肥新汇成微电子股份有限公司未确认持有人证券专用账户,共计147,903,000股。综上,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)与汇成投资控股有限公司、杨会和宝信国际投资有限公司构成一致行动人。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

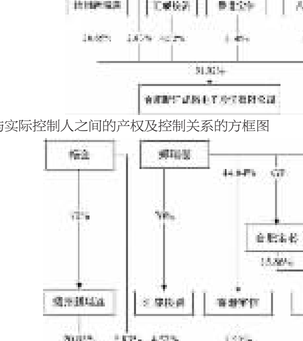
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

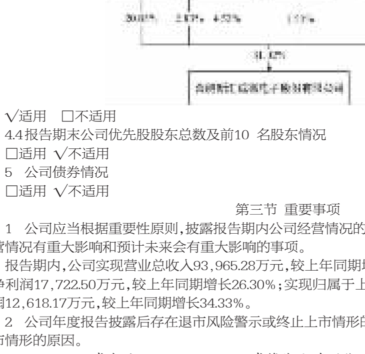
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入93,965.28万元,较上年同期增长18.09%;实现归属于上市公司股东的净利润17,722.50万元,较上年同期增长26.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,618.17万元,较上年同期增长34.33%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-005

合肥新汇成微电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

●公司2022年度不进行利润分配,系考虑到公司目前处于持续扩产阶段,固定资产投入高、设备购置资金量需求大,需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展,继而更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币177,224,972.73元,截至2022年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为人民币-64,652,563.52元,母公司期末未分配利润为人民币271,876,230.85元。

经第一届董事会第十四次会议决议,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处的集成电路高端先进封装测试行业属于技术、资金与人才密集型的高新技术产业,固定资产投资规模较大,且在人才引进、技术研发等方面均存在一定的资金需求。2022年下半年起,受宏观经济、国际局势、终端需求低迷等多方面影响,集成电路封测行业呈现下行趋势,尽管近期行业景气度有所回升,但公司仍面临一定的经营资金周转压力,特别是考虑到后续产能扩充计划需要持续购置设备,公司存在预留经营资金的需要。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司在显示驱动芯片封测领域深耕多年,未来公司拟延伸产品线,进军先进封装测试行业其他细分领域,响应客户需求变化,不断跟随市场趋势丰富产品结构、提升技术实力和产业链资源整合能力。除显示驱动芯片外,目前公司在其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累与扩张阶段,与其他细分领域内的头部公司存在一定差距,存在预留资金用于新技术研发及验证的需求。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司于2021年度实现扭亏为盈,2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币177,224,972.73元。受子公司累亏影响,截至2022年末公司合并报表未分配利润为人民币-64,652,563.52元,合并报表层面尚未实现盈利。

产能是公司综合竞争力的重要体现,为满足客户日益增长的产能需求,提升公司综合竞争力,公司仍处于持续扩产阶段,固定资产投入较高、设备购置资金量需求较大,需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展,保障公司的可持续发展。

(四)上市公司未进行现金分红的原因

考虑到公司目前处于持续扩产阶段,固定资产投资规模较大,并且为布局新产品需要持续研发投入,需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展。为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司可持续发展,公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年度未分配利润将累计滚存至下一年度,以满足公司设备购置、产能扩充、经营周转、研发投入、人才引进等方面的资金需求,以增强公司核心竞争力,进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况等因素,秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议,有效表决票7票,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为:充分考虑到公司目前处于持续扩产阶段,固定资产投入高、设备购置资金量需求大,需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展,该利润分配预案有利于更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展。综上,公司董事会一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,公司全体独立董事一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月20日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、内部制度中关于利润分配的规定,不存在损害公司及股东整体利益的情形。综上,公司监事会一致同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-008

合肥新汇成微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号")及《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")变更相应的会计政策。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)本次会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部颁布了准则解释第15号,规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容,其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部颁布了准则解释第16号,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自2022年11月30日起施行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更日期

根据准则解释第15号的相关要求,公司决定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起执行。

根据准则解释第16号的相关要求,公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起执行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自2022年11月30日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-006

合肥新汇成微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定,将合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"汇成股份"或"汇成股份公司")2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1256号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票166,970,656股,每股面值1元,发行价为每股人民币8.88元,募集资金总额为1,482,699,425.28元,坐扣承销费128,269,942.53元(不含增值税)、保荐费3,000,000.00元(不含增值税)后的募集资金为1,351,429,482.75元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用31,069,835.33元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额1,320,359,647.42元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年8月12日出具《验资报告》(天健验〔2022〕412号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币31,274.84万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	132,035.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	100,961.92
	利息收入净额	C2	200.79
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	100,961.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	200.79
应结余募集资金		E=A-D1+D2	31,274.84
实际结余募集资金[注]		F	31,274.84
差异		G=E-F	

[注]其中公司募集资金专户存放的活期存款余额4,274.84万元(见本专项报告二(二)之说明),结构性存款余额27,000.00万元(见本专项报告三(四)之说明),本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月11日分别与中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	1302045719100295856	22,616.14	募集资金专户
本公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001168508	49.45	募集资金专户
本公司	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100365322	42,087,347.26	募集资金专户
本公司	招商银行股份有限公司合肥分行	514902669010558	638,347.62	募集资金专户
	合计		42,748,360.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币39,672.78万元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审验,并由其于2022年9月26日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕9785号)。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-003)。

截至2022年12月31日,上述置换事项已完成。

(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金 进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

本期购买及赎回理财产品(含结构性存款)如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	购买日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
招商银行合肥分行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	15,000.00	2022-9-30	2022-10-31	34.40	是	
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	15,000.00	2022-10-18	2022-11-18	34.52	是	
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	10,000.00	2022-11-1	2022-12-1	22.27	是	
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	5,000.00	2022-11-1	2023-1-31		否	5,000.00
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	兴业银行人民币企业金融结构性存款	3,000.00	2022-11-30	2022-12-30	6.36	是	
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款	12,000.00	2022-12-1	2023-1-5		否	12,000.00
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款	10,000.00	2022-12-5	2022-12-29	16.45	是	
招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	10,000.00	2022-12-30	2023-2-1		否	10,000.00
合计		80,000.00			114.01		27,000.00

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七) 使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在节余募集资金投资使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月26日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。由于公司首次公开发行实际募集资金净额132,035.96万元少于招股说明书披露的拟投入的募集资金金额156,386.99万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的投资总额见本报告附件1。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-001)。

(十) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"12吋显示驱动芯片封测扩能项目"是以公司为实施主体,建设周期为18个月,是公司利用现有厂区,在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后,公司12吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。由于该项目需与其他产线配套使用,无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

"研发中心建设项目"以公司为实施主体,建设周期为24个月。项目建成后将大幅提高公司研发的软硬件基础,进一步提升研发实力。本项目针对凸块结构优化、测试效率提升、倒装技术键合品质、CMOS图像传感器封装工艺等加大研发投入,提升公司产品质量及生产效率,丰富公司产品结构,提升整体市场竞争力,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,本公司不存在首发募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为,汇成股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定,如实反映了汇成股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2022年12月31日,汇成股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对汇成股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:合肥新汇成微电子股份有限公司

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				132,035.96	本年度投入募集资金总额							100,961.92
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							100,961.92
变更用途的募集资金总额比例												
12吋显示驱动芯片封测扩能项目	否	97,406.15	78,000.00	78,000.00	51,111.51	51,111.51	-26,888.49	65.53	项目计划建设期为18个月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,980.84	5,000.00	5,000.00	814.00	814.00	-4,186.00	16.28	项目计划建设期为24个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	49,035.96	49,035.96	49,036.40	49,036.40	0.44	100.00		不适用	不适用	否
合计	–	156,386.99	132,035.96	132,035.96	100,961.92	100,961.92	-31,074.05	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)利用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(九)募集资金使用的其他情况"								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:上表中合计值尾差系四舍五入导致。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-009

合肥新汇成微电子股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度并提供担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司为满足生产经营和发展需要,拟向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的授信额度,同时,公司拟为全资子公司江苏汇成光电有限公司(以下简称"江苏汇成")申请金融机构授信提供预计不超过人民币2亿元的担保额度,最终授信金额及担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

●被担保人名称:江苏汇成光电有限公司(系公司全资子公司)。

●截至本公告披露日,公司对子公司已实际发生的担保余额为0元。

●本次担保不存在反担保。

●本次申请综合授信额度及提供担保事项在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

一、2023年度申请综合授信额度并提供担保基本情况

为满足生产经营和发展需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、承兑汇票、保函、信用证、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等,具体授信业务品种、额度和期限以金融机构最终批复为准,上述授信额度自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。以上授信额度不等于公司的实际授信金额,实际授信金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

同时,为满足生产经营和发展需要,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司江苏汇成提供预计合计不超过人民币2亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保事项的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次申请授信额度及提供担保事项在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向银行等金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

1、名称:江苏汇成光电有限公司

2、成立日期:2011年8月29日

3、注册地点:扬州高新区金荣路19号

4、法定代表人:郑瑞俊

5、注册资本:人民币56,164.02万元整

6、经营范围:半导体(硅片及化合物半导体)集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试,销售本公司自产产品及售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:江苏汇成为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8、主要财务数据和指标:

金额单位:人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年度
资产总额	58,844.24
负债总额	54,612.01
净资产	4,232.22
营业收入	22,247.77
净利润	-160.27
扣除非经常性损益后的净利润	-1,707.91
资产负债率	92.81%

注:上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

江苏汇成为公司全资子公司,不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及全资子公司尚未签订与上述授信相关的担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准,担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司江苏汇成发展规划和生产经营的需求,结合公司2023年度发展计划进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要;且江苏汇成生产经营稳定,资信状况良好。本次为江苏汇成提供的担保无反担保。

五、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为0元,公司对控股子公司担保余额为0元,无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

六、董事会意见

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保事项的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事会认为,申请授信并提供担保满足公司及全资子公司经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保对象为公司全资子公司,公司对相关风险能够进行有效控制。公司董事会一致同意该议案。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

2023年4月20日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保事项的议案》。经核查,监事会认为:本次公司及全资子公司申请不超过人民币4亿元的授信额度,同时,公司为全资子公司江苏汇成提供预计合计不超过人民币2亿元的担保额度,是为了满足公司生产经营和业务发展需要,公司对相关风险能够进行有效控制,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。综上,监事会一致同意公司2023年度申请综合授信额度并提供担保事项。

(二)独立董事意见

经核查,公司全体独立董事认为:公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的授信额度及公司为全资子公司提供预计合计不超过人民币2亿元的担保额度事项是为满足公司及全资子公司经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,公司对相关风险能够进行有效控制,决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事一致同意公司2023年度申请综合授信额度并提供担保事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次申请授信额度及提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定;本次申请授信额度及提供担保事项基于公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次申请授信额度及提供担保事项无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2023-010

合肥新汇成微电子股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

一、本次薪酬方案所履行的审议决策程序

鉴于《关于2023年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

关联董事郑瑞俊担任公司董事长、总经理、董事会秘书(代行),回避表决《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案有效表决票6票,同意6票,会议审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于2023年度监事薪酬方案的议案》获得第一届监事会第八次会议审议通过,本议案有效表决票3票,同意3票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本次薪酬方案适用对象

公司2023年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

三、本次薪酬方案适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

四、薪酬标准

(一)董事

1、非独立董事

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴;不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬或董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴4.80万元/年。

(二)监事

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬,不另外领取监事津贴;不在公司任职的监事,不领取薪酬或监事津贴。

(三)高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

五、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

2、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以

(下转B173版)